

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【公開番号】特開2004-22290(P2004-22290A)

【公開日】平成16年1月22日(2004.1.22)

【年通号数】公開・登録公報2004-003

【出願番号】特願2002-174419(P2002-174419)

【国際特許分類第7版】

H 01 H 37/76

【F I】

H 01 H 37/76 Q

【手続補正書】

【提出日】平成17年5月31日(2005.5.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路部品搭載用配線ランドを有する実装基板と、一対のリード部材間に架設配置された表面にフラックス被膜を有する低融点可溶合金を絶縁ケースに収納してキャップで封止した気密パッケージのチップ部品とを具備し、前記一対のリード部材は前記絶縁ケースの内部に電極部と外部に導出部を有し、前記配線ランドと前記リード部材の導出部を圧接接合により前記実装基板上に前記チップ部品を搭載したチップタイプ温度ヒューズの実装構造。

【請求項2】

前記一対のリード部材はその導出部が銅、リン青銅、鉄、ニッケルあるいはこれに印刷またはメッキ処理してなり、前記実装基板に設けた印刷導体からなり、前記配線ランドとの圧接接合時の熱圧着による溶着を容易にしたことを特徴とする請求項1に記載のチップタイプ温度ヒューズの実装構造。

【請求項3】

前記実装基板は前記チップ部品を適正配置する位置決め手段を有し、前記リード部材の導出部は前記配線ランド間に適合するようにフォーミングをしたことを特徴とする請求項2に記載のチップタイプ温度ヒューズの実装構造。